

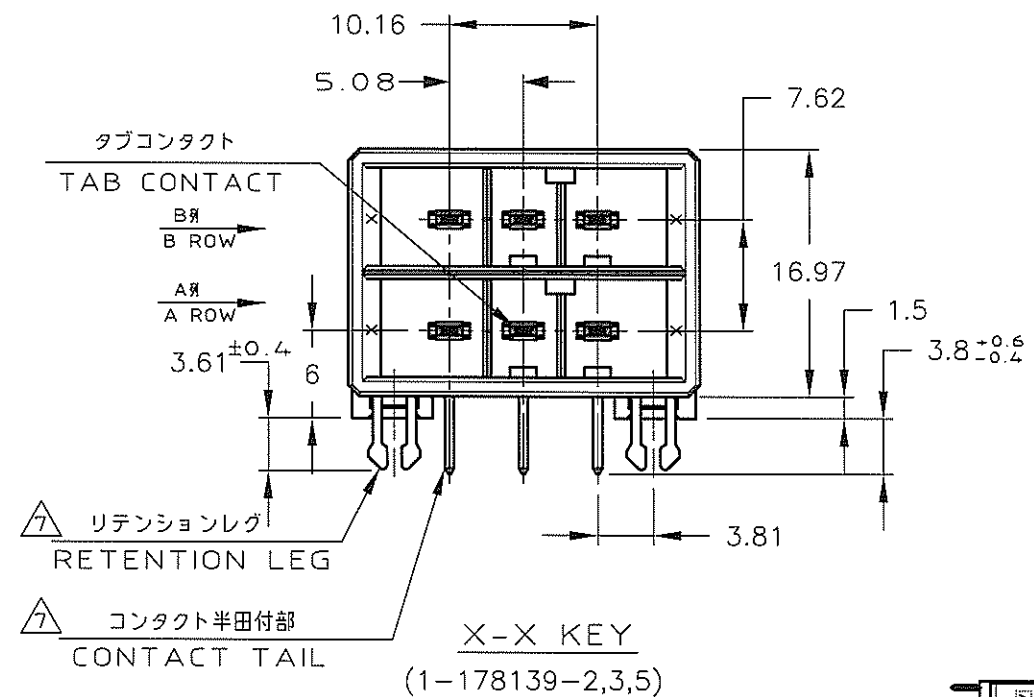
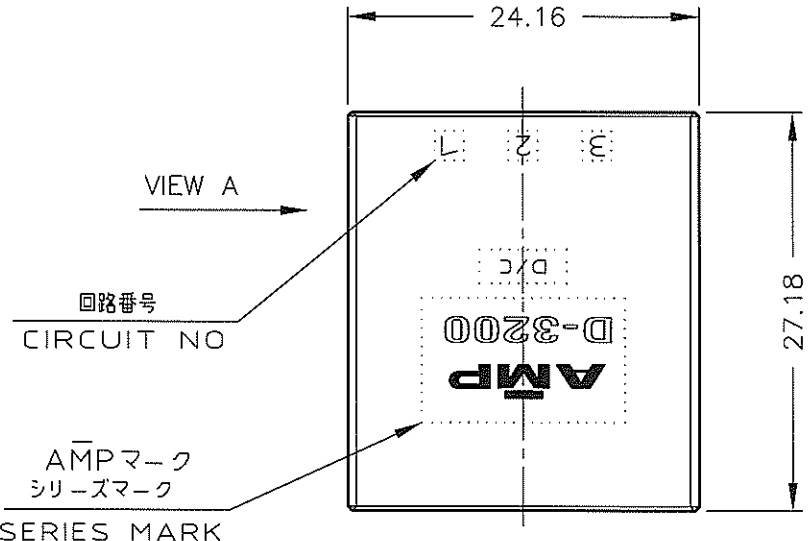
NUMBER 178139

3rd ANGLE PROJECTION

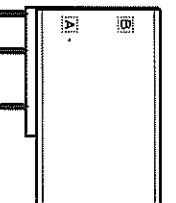
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

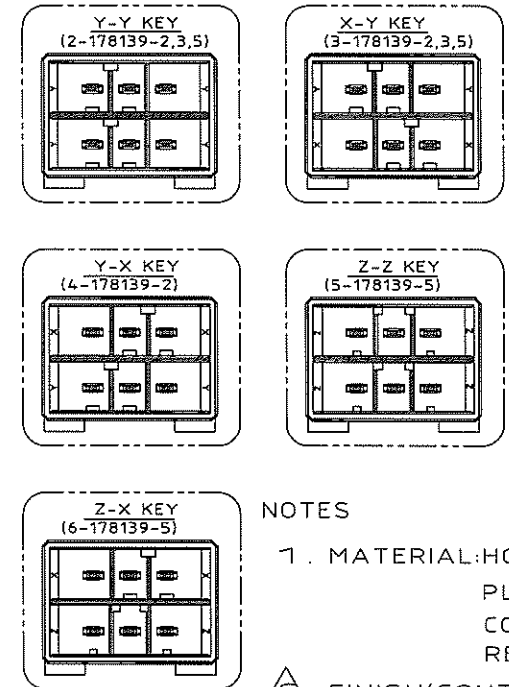
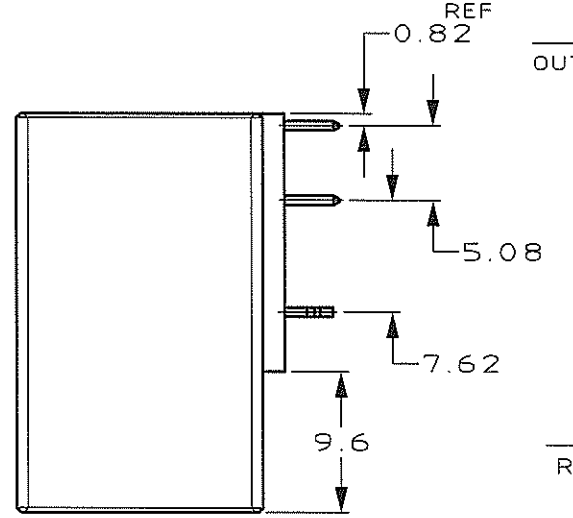
PRINT DIST



△ 4	△ 2	1,2,3,5,6-178139-5
△ 3	△ 1	1,2,3-178139-3
△ 2	△ 1	1,2,3,4-178139-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

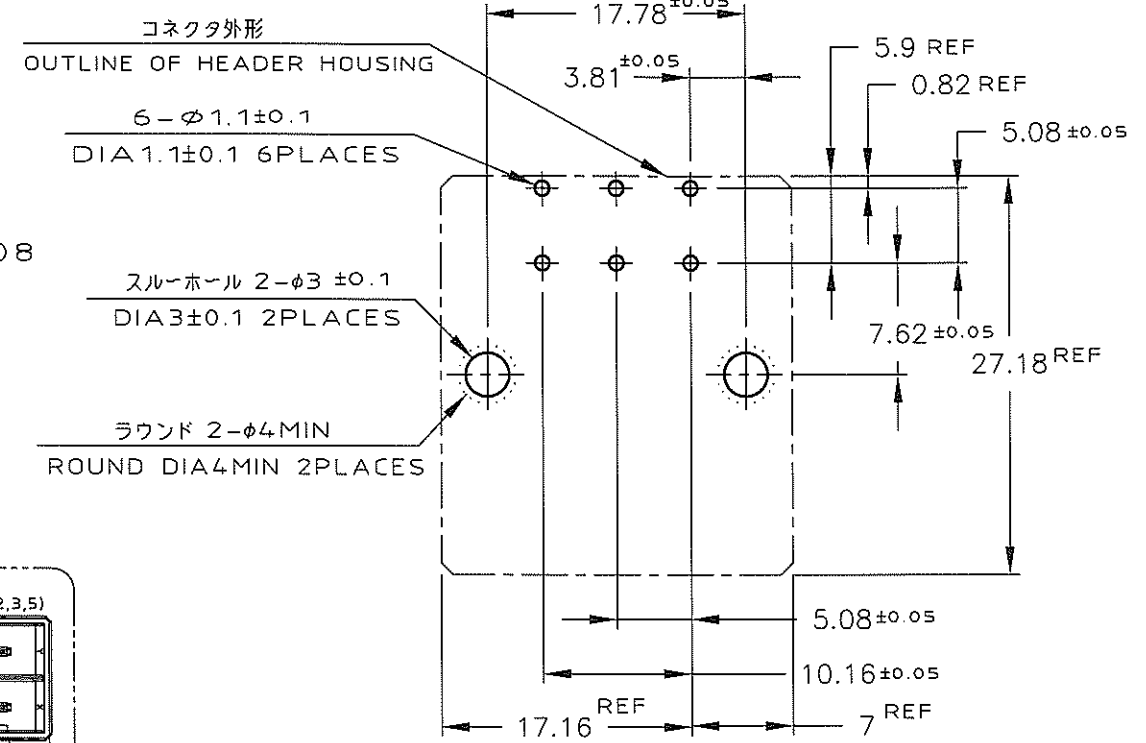


VIEW A
(SCALE:1:1)



NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- PRODUCT SPEC: 108-5349
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエスチル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- 製品規格: 108-5349
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

								TE Connectivity			
				WIRE RANGE				INSULATION DIA			
				mm ² (AWG -)				mmφ			
				MATERIAL				FINISH			
				SEE NOTE				SEE NOTE			
				注記参照				注記参照			
E3 REVISED PER ECO-11-005030				DR. K.IKEDA				DE. K.IKEDA			
LTR REVISION RECORD				CHK. S.MANABE				APP. S.MANABE			
				NAME				6 POS SINGLE ROW			
								HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200			
				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				SIZE LOC NUMBER			
				10% ±0.3				A3 J C-178139			
				10% ±0.4				SCALE 2-1			
				10% ±0.45				REV. E3			
								SHEET 1 OF 1			